

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名称	线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 9 月 1 日
地点	网络互动
上市公司 接待人员姓名	董事长：张兵 常务副总经理兼董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏 独立董事：李挺
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司上半年营业收入同比增长 50.64%，收入增长的主要驱动因素是什么？ 答：公司上半年营业收入增长主要是公司在各领域均表现出良好的增长趋势，同时境外子公司 INOFINE 收入纳入合并范围，总体收入实现稳健增长。其中电镀液及配套试剂同比增长 64.32%，光刻胶及配套试剂同比增长 53.49%。公司始终聚焦半导体业务，坚守“差异化竞争，全球化布局”的核心发展理念和“一主两翼、内生外延双轮驱动”的发展战略，持续加大先进封装和晶圆领域的研发投入及市场开拓力度，公司的

营业收入呈现出持续增长的态势。

问题二：目前公司在海外市场开拓情况如何？

答：公司正加速推进海外供应链布局与渠道建设。通过与马来西亚子公司 INOFINE 的融合，引进了具备海外资源与经营管理经验的本土团队，为公司布局海外市场奠定了基础。INOFINE 成立于 2009 年，作为马来西亚本土较早涉足半导体湿电子化学品业务的企业，在当地市场具有一定的影响力。自 2025 年起，INOFINE 纳入公司合并报表范围，东南亚及其他海外业务将成为公司未来新的业务增长点。未来公司将充分发挥自身的技术优势、品牌优势、产业链协同优势以及系统化服务优势，持续提升公司在国际市场的影响力与竞争力。

问题三：请问南通艾森、INOFINE 的经营表现及对整体业绩的贡献？

答：南通艾森作为公司制造中心，是公司募投项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”实施主体。INOFINE 作为公司开拓东南亚市场的重要渠道，2025 年起已纳入公司合并报表范围，东南亚及其他海外业务将成为公司未来新的业务增长点。此次并购为公司进一步拓展海外市场奠定了坚实基础。

问题四：您好，报告期内公司研发投入增长 44.50%，有哪些重点研发成果或项目可以分享吗？

答：报告期内公司研发投入 3,041.99 万元，同比增长 44.50%，主要系公司进一步加大先进封装及晶圆制造领域，尤其光刻胶等高端及“卡脖子”产品的研发投入，重点研发成果和项目如下：先进封装及晶圆制造领域电镀液和光刻胶产品的研发，包括晶圆制造 5-14nm 制程超纯硫酸钴、28nm 制程大马士革电镀铜添加剂、超高感度 PSPI、ICA 化学放大光刻胶、KrF 光刻胶等；先进封装用负性光刻胶、电镀铜添加剂、电镀锡银添加剂、TSV 高速镀铜添加剂等。公司 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已经通过主流晶圆客户的认证，进入量产阶段；公司负性光刻胶已成功拓展应用到玻璃基封装，获得头部客户量产订单；另外公司将电镀铜产品逐步推向 HDI、SLP、IC 载板应用领域，公司 Tenting 快速填充镀铜产品已成功导入头部 HDI 和 SLP 供应链，实现批量供货。

问题五：下半年业绩增长点及全年业绩预期？

答：公司未来的业绩增长点主要体现在产品 and 市场两个方面：（1）产品方面，公司在先进封装、晶圆制造等领域将持续发力，随着先进制程的电镀液及添加剂以及各类型光刻胶在下游客户测试认证通过，销售收入有望实现持续增长；（2）市场方面，公司持续布局海外市场，包括马来西亚在内的东南亚市场将成为公司未来盈利增长的重要部分。

问题六：经营现金流大幅改善，票据付款方式对现金流管理的长期作用如何？

答：公司销售回款情况良好。公司经营性现金流存在波动主要系受票据贴现或背书比例的影响。2025 年上半年，公司减少票据贴现（计入融资活动现金流），增加票据付款，从而有效改善经营性现金流。公司将持续根据票据市场情况，合理规划票据使用，以实现公司利益最大化。

问题七：领导您好，公司如何应对海外业务的汇率波动和贸易政策风险？

答：1、公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，并根据外币资产规模合理选择相应的金融工具进行对冲，以最大程度降低面临的外汇风险；2、公司将持续加强海外供应链的建设，提升生产和销售的结合能力，优先选择政治稳定、贸易协定覆盖的区域拓展业务，最大限度降低贸易政策对于公司经营的影响。

问题八：半导体材料市场增长趋势对公司业务的利好有哪些？

答：半导体材料市场的持续增长为公司提供了广阔的市场空间和增长机遇，公司通过技术创新、产品突破、国产化替代等举措，有望持续受益于行业发展趋势，实现业绩的稳健增长。

1、技术升级与新兴应用：5G、AI、物联网等技术发展推动半导体制造向更先进制程（如 3nm 以下）演进，对高纯度化学品需求增加。

2、国产化替代加速：随着我国集成电路国产化进程的加深，在半导体工艺持续升级与下游应用领域的蓬勃发展的背景下，我国半导体材料行业将拥有广阔发展前景。公司作为国内领先的电子化学品研发与生产商，将受益于国产化替代的加速，进一步提升市场份额。

3、技术创新和产品突破：公司在电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等关键产品方面已实现技术突破，特别是在先进封装、

	晶圆制造等领域。公司相关产品的技术突破和规模供应，有力地推动了我国在半导体关键材料领域竞争力的提升，为实现半导体材料国产化替代目标作出了积极贡献。4、政策支持和市场需求：半导体行业发展已进入一个以技术创新、市场需求和政策扶持三重驱动的关键时期。在各级政府和全社会的支持下，中国集成电路产业持续推进结构性升级，展现出韧性与创新突破。公司作为行业内的重要企业，将受益于政策支持和市场需求的持续增长。 问题九：请问先进封装材料领域的差异化竞争优势和战略定位是什么？ 答：公司在先进封装材料领域的差异化竞争优势主要体现在技术研发、产品创新、市场份额、产业链支持以及国产替代等方面，战略定位为国内领先、国际接轨的半导体关键材料供应商。1、技术壁垒突破，适配 2.5D/3D 封装、HBM 封装、CoWoS 封装、混合键合以及玻璃基板封装等尖端封装材料，需满足高精度、低缺陷要求，技术门槛显著高于传统封装材料。公司前瞻性地布局了覆盖主流先进封装工艺的完整材料解决方案，已构建起匹配上述核心工艺的全系列产品矩阵，实现了多项关键产品的国产化替代。2、市场份额和行业地位：公司在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场的占有率超过 20%，成为该领域引领研发与应用的领先企业，成功跻身国内第一梯队供应商行列。3、产业链支持：公司凭借跨领域的完整产品组合，能够在不同制程节点和封装形式下为客户提供稳定、优异的电镀性能支持，助力半导体产业向更高性能、更高集成度持续迈进。4、研发投入和专利技术：公司高度重视产品研发和技术积累，拥有多项电子化学品的关键专利技术，具备了自主开发多类半导体用化学品的技术能力。5、国产替代和市场前景：公司的相关产品技术突破和规模供应，推动了我国在半导体关键材料领域竞争力的提升，为实现半导体材料国产化替代目标作出了积极贡献。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无

日期	2025 年 9 月 1 日
----	----------------